

USB3.1C S1V DN1 RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	OMNIMATE Data - gniazdo USB, Gniazda USB, Przyłącze lutowane SMD, 180°, ≥ 10000, Raster w mm (P): 0.50 mm, Liczba biegunów: 24, LCP, czarny, Szpuła
Nr zam.	2987540000
Typ	USB3.1C S1V DN1 RL
GTIN (EAN)	4099986854994
Ilość	450 Szt.
opakowanie	Szpuła

Data sporządzenia 24 czerwca 2024 15:08:51 CEST

Aktualizacja katalogu 14.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

USB3.1C S1V DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	4,3 mm	Głębokość (cale)	0,169 inch
Wysokość	9,25 mm	Wysokość (cale)	0,364 inch
Szerokość	8,94 mm	Szerokość (cale)	0,352 inch
Masa netto	10 g		

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	750 V AC
napięcie znamionowe	5 V		

Specyfikacje systemu

Cykle wpinania	≥ 10000	Długość pinu do lutowania (l)	1,15 mm
Ekranowanie	360° styk ekranowany	Liczba biegunów	24
Materiał ekranu	Stal nierdzewna, mosiądz	Powierzchnia ekranu	niklowany
Proces lutowania	Lutowanie rozpliwowe, Lutowanie ręczny	Raster w mm (P)	0,5 mm
Rodzina produktów	OMNIMATE Data - gniazdo USB	Stopień ochrony	IP20
Zaciski ekranu	brak	kąt odejścia	180°
liczba kołków lutowanych na biegun	1	montaż na płytce drukowanej	Przyłącze lutowane SMD
zamknięcie boczne, właściwość	Brak		

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	LCP	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	Wytrzymałość izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Moisture Level (MSL)	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
podstawowy materiał styku	stop miedzi	Materiał styków	stop brązu fosforowego
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Temperatura pracy, min.	-30 °C
Temperatura pracy, max.	80 °C		

Opakowanie

opakowanie	Szpula	Długość VPE	0
Szerokość VPE	0	Wysokość VPE	0

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

USB3.1C S1V DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Katalogi

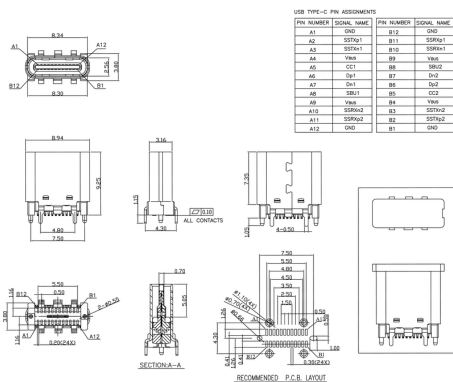
[Catalogues in PDF-format](#)

USB3.1C S1V DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.